



2021年6月29日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ プ ト ラ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 林 為 平
(コード番号：6235 東証第一部)
問 合 わ せ 先 取 締 役 執 行 役 員 山 田 満 男
経 営 管 理 部 長
(TEL. 03-6635-9487)

光学デバイス向けドライエッチング装置を実用化

弊社は、光学デバイス向けドライエッチング装置開発において、高度エッチング技術と環境負荷軽減を同時に可能とする新型装置を開発し、受注体制に入りましたのでお知らせします。

エッチング技術は半導体、MEMS、LEDに加えて光学デバイス向けにも応用されており、金属膜や絶縁膜にパターンニングすることで微細な加工が可能です。エッチング装置の量産性を高め生産効率を改善し、さらにSDGsを意識した環境負荷軽減を同時に実現出来れば、さらに光学向け用途が拡大する見込みがありました。そこで、弊社は光学薄膜成膜装置で培った真空技術やプラズマ技術等をエッチング技術に適用し、新型光学デバイス向けドライエッチング装置を完成しました。これにより、エッチング時の加熱冷却が基板全面に効率的かつ均一に行えるようになり、生産性の向上とエッチング応用分野の拡大が可能になります。また、従来多用されてきたウエットエッチングにより排出される廃液問題処理負担を軽減することも可能となりました。

ドライエッチング装置開発の完成により、従来の光学薄膜成膜装置に加えて弊社装置製品群を拡充し、さらに微細で多様な成膜ニーズに応じられるようになりました。今回実用化した装置は、スマートフォン、ノートパソコン、車載等のタッチパネルやディスプレイのカバーガラスへのドライエッチングによる防眩加工が主な利用対象で、対応するガラス基板のサイズは、最大で第5.5世代(1300mm×1500mm)となります。今後は、更に、LED・RFフィルターデバイス等に対応したエッチング装置も完成させていきます。

当社は、引き続き、研究開発を加速させ、光学薄膜および半導体関連技術を応用した総合成膜装置メーカーとして、事業範囲の拡大を目指すと共に、持続可能な社会の実現に向け、SDGs・ESGへの取り組みを重視し、環境負荷を低減した製品開発にも取り組んでまいります。

※ドライエッチングとは、真空チャンバーに反応性ガスを導入し、プラズマを生成してエッチング処理を行うことをいいます。

以上